

吉林华微电子股份有限公司 关于聘任公司高管的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 20 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，结合公司发展战略规划和经营管理的需要，经公司董事长、总经理于胜东先生提名，聘任孟鹤先生、李斌晖先生、李强先生、钮立君先生为公司副总经理（简历详见下方附件）。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日

附件：

孟鹤个人简历：孟鹤，男，1983年3月出生，本科学历，高级工程师。曾在吉林麦吉柯半导体有限公司工作，现任吉林华微电子股份有限公司董事、总经理助理、芯片制造部总经理、深圳吉华微特电子有限公司董事。

李斌晖个人简历：李斌晖，男，1971年6月出生，本科学历，高级工程师、高级经济师、政工师。曾任吉林华微电子股份有限公司综合计划部部长、市场营销部经理、华南公司总经理、海外业务部经理、事业部经理、事业部总经理，吉林麦吉柯半导体有限公司总经理。现任吉林华微电子股份有限公司总经理助理、吉林麦吉柯半导体有限公司董事长。

李强个人简历：李强，男，1975年9月出生，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任吉林华微电子股份有限公司工艺经理、产品总监、技术工程部经理、首席技术官。现任吉林华微电子股份有限公司总经理助理、吉林华耀半导体有限公司董事长。

钮立君个人简历：钮立君，男，1976年3月出生，本科学历，高级工程师。曾任吉林华微电子股份有限公司设备工程师、设备经理、设备工程部经理，现任吉林华微电子股份有限公司总经理助理、设备管理部经理。